

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-18

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 现场参观 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 其他（ <u>券商策略会</u> ）
活动参与人员（排名不分先后）	华富基金、国泰海通、太平洋保险、睿远基金、中财投资、中国人寿、国融证券、宏鼎财富管理、新华股份、国信证券、世纪证券、上海南土、博衍私募、中信建投证券、汇添富基金、南方天辰、涌乐私募、中信资管、中信证券、国金证券、国投证券
上市公司接待人员	副总经理、董事会秘书：张丽君；战略发展部总监、证券事务代表：谢丹； 证券事务主管：阳佩琴；投资者关系经理：郭家旭
时间	2025 年 5 月 13 日
地点	国投证券策略会、国金证券策略会、公司会议室
形式	实地调研
投资者关系 活动主要内容介绍	交流主要内容： Q1、请介绍公司 2025 年第一季度 PCB 业务经营拓展情况。 公司在 PCB 业务产品下游应用以通信设备为核心（覆盖无线侧及有线侧通信），重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子（聚焦新能源和 ADAS 方向）等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。2025 年第一季度，公司 PCB 业务通信领域无线侧订单较去年第四季度小幅度回升，有线侧交换机等需求保持增长，有线侧通信订单比重高于无线侧通信。数据中心领域订单环比继续增长，主要得益于 AI 加速卡、服务器等产品需求增长。汽车电子继续把握在新能源和 ADAS 方向的机会，需求平稳增长。 Q2、请介绍公司 2025 年第一季度封装基板业务经营拓展情况。 公司封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。具备了包括 WB、FC 封装形式全覆盖的封装基板技术能力。2025 年第一季度，公司封装基板业务需求较去年第四

季度有一定改善，主要得益于存储类产品需求提升。

Q3、请介绍公司近期经营情况及工厂产能利用率情况。

公司近期各项业务经营正常，综合产能利用率仍处于相对高位，其中 PCB 业务因目前算力及汽车电子市场需求延续，近期工厂产能利用率保持高位运行；封装基板业务因近期存储领域需求相对改善，工厂产能利用率较 2024 年第四季度有所提升。

Q4、请介绍公司对美国销售收入的规模，美国关税政策对公司经营可能产生的影响。

2024 年及 2025 年第一季度，公司对美国直接销售收入占公司营业收入比重较低，公司整体受影响的范围较小。由于相关事项仍在动态演变中，产业链相关各方尚需时间对当前国际经贸环境发生的新变化进行研判并采取行动。公司正保持密切关注，并与产业链各相关方持续进行沟通，共同协商解决方案，做好灵活应对。

Q5、请介绍公司 FC-BGA 封装基板产品技术能力及广州封装基板项目爬坡进展。

公司 FC-BGA 封装基板现已具备 20 层及以下产品批量生产能力，各阶产品相关送样认证工作有序进行。20 层以上产品的技术研发及打样工作按期推进中。

公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力持续提升，产能爬坡稳步推进，已承接 BT 类及部分 FC-BGA 产品的批量订单，但总体尚处于产能爬坡早期阶段，由此带来的成本及费用增加，对公司利润造成一定负向影响。得益于各类订单逐步投入生产，广州封装基板项目在 2025 年第一季度亏损环比已有所收窄。

Q6、请介绍公司 PCB 业务近年来扩产规划。

公司 PCB 业务在深圳、无锡、南通及泰国项目（在建）均设有工厂。一方面，公司通过对现有成熟 PCB 工厂进行技术改造和升级，打开瓶颈，提升产能；另一方面，公司有序推进南通四期项目建设，构建 HDI 工艺技术平台和产能，目前正在推进项目基础工程建设。公司将结合自身经营规划与市场需求情况，合理配置业务产能。

Q7、请介绍公司泰国工厂投资规模及业务定位。

公司在泰国工厂总投资额为 12.74 亿元人民币/等值外币。目前基础工程建设按期有序推

	进中，具体投产时间将根据后续建设进度、市场情况等因素确定。泰国工厂将具备高多层、HDI 等 PCB 工艺技术能力，其建设有利于公司进一步开拓海外市场，满足国际客户需求，完善产品在全球市场的供应能力。 Q8、请介绍公司对电子装联业务的定位及布局策略。 公司电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，按照产品形态可分为 PCBA 板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信及数据中心、医疗、汽车电子等领域。公司发展电子装联业务旨在以互联为核心，协同 PCB 业务，发挥公司电子互联产品技术平台优势，通过一站式解决方案平台，为客户提供持续增值服务，增强客户粘性。 Q9、请介绍原材料价格变化情况及对公司的影响。 公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多。2025 年一季度，受大宗商品价格变化影响，金盐等部分原材料价格同比提升、较 2024 年第四季度亦出现一定涨幅。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。 Q10、请介绍公司 PCB 业务在 AI 算力方面的布局情况。 伴随 AI 技术的加速演进和应用上的不断深化，电子产业对于高算力和高速网络的需求日益迫切，驱动了行业对于大尺寸、高层数、高频高速、高阶 HDI、高散热等 PCB 产品需求的提升。2024 年以来，公司 PCB 业务在高速通信网络、数据中心交换机、AI 加速卡、存储器等领域的 PCB 产品需求均受益于上述趋势。 Q11、请介绍公司封装基板业务主要客户类型。 公司封装基板业务客户覆盖国内及海外厂商。从客户所处产业链环节看，公司封装基板业务主要面向 IDM 类（半导体垂直整合制造商）、Fabless 类（半导体设计商）以及 OSAT 类（半导体封测商）厂商。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单	无
------	---